

# **GATS**°-7836

# 半導体パッケージ向け高速・高精度検査装置

High speed and high accuracy inspection system for semiconductor package



## 大型個片/クォーターパネル 高精度検査装置

High accuracy inspection system for Large unit and Quarter panel

# チップレットなどの大型・多ピン基板対応

For large size substrate like chiplet with many test points

### 多様なオートメーション要求に対応

Meet with various automation request

# アドバンスドパッケージ対応導通絶縁検査装置

**Advanced Package inspection system** 

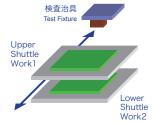
### 総合アライメント精度 ±2.5µm

Comprehensive alignment accuracy ±2.5µm

#### 上下ダブルシャトル式

Vertical Double Shuttle Mechanism





■ダブルシャトル方式による高速検査 High-speed inspection by double shuttle mechanism

### 高速/高精度 OPEN/LEAK TESTER

High speed and high accuracy Open/Leak tester



- ■高速検査と高精度検査の両方を実現! High speed and high accuracy inspection!
- ■低抵抗から高抵抗の導通・短絡検査を カバーするワイドレンジ測定 OPEN/LEAK inspection with a wide range resistance

### **Key Specification**

検査部 Inspection section	Step & Repeat mechanism
Maxピン数 Maximum Test point	Top/Bottom:32,768ch (4Kch*8QD-Block)
ワークサイズ Work Size	Unit □120~160mm Quarter (W)220~250*(D)230~300mm
ワーク厚み Thickness	Unit 0.5~3.0mm Quarter 0.4~3.3mm
KOZ (MIN)	6.0mm
総合アライメント精度 Alignment accuracy	+/-2.5µm
ワークホルダ Work Holder	4-sided clamp/Tension mechanism
プレス能力 Press capability	Upper / Lower:max 200kgf
装置サイズ(想定) Equipment size (expected)	(W)1,920*(D)2,400*(H)2,200mm (Without L/UL)

※開発中の装置につき、実際の仕様とは異なる場合があります。 This system is under development. so the actual machine specification could be changed.

ニデックアドノじンステクノロジー株式会社